

Investor Relations 3Q.2017

Your Most Trustworthy



유의사항 Disclaimer

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

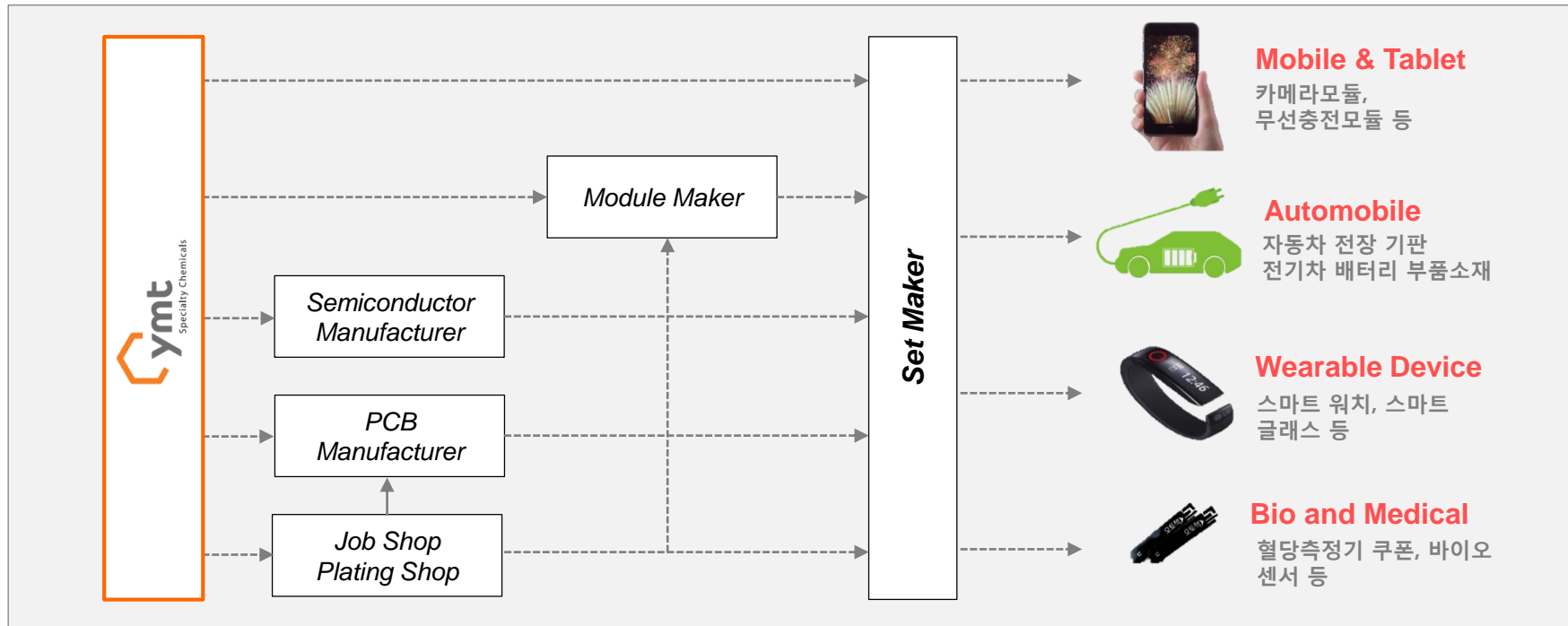
또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

와이엠티는 전자소재 산업에서 반드시 필요한 **화학소재를 직접 개발 / 제조 / 납품하는 회사**로써, 모바일 뿐만 아니라 전기자동차, 웨어러블 디바이스, 바이오 센서 등에서도 그 가치를 인정받고 있습니다.

- ✓ 주요 표면처리 분야 : 무전해금도금 프로세스 [Soft ENIG / ENIG / ENEPIG], 무전해 화학동, 프로세스 케미컬
- ✓ 주요 고객사 : 영풍전자, 삼성전기, 인터플렉스, 비에이치, Foxconn 등



YMT Co.,Ltd.

- 회사명 • 와이엠티(주)
- 설립일 • 1999. 02. 11
- 대표자 • 전성욱 (표면처리 기술사)
- 종업원 • 본사 147 (한국 : 137명 / 대만 10명)
- 소재지 • 인천광역시 남동구 남동동로 153번길 30
- 자본금 • 1,851 백만원
- 주요제품
 - PCB 화학소재
 - 전자소재 분야
 - 표면처리외주도금[YPT]
- 주요시장
 - 모바일용 기판 및 모듈
 - 무선충전기용 모듈
 - Auto mobile 용 전장 부품
 - 바이오 센서 등

YMT 계열사

YMT Shenzhen

- PCB 화학소재 중국 판매 법인
- 심천에 위치하고 있으며, 중국 및 대만계열 고객사 확보

YMT Taiwan Branch

- PCB 화학소재 대만 판매지사
- Taoyuan 위치, 대만에 위치한 PCB 본사 영업

YMT Vina

- PCB 화학소재 판매 및 제조법인
- 박닌성 위치, 베트남에 진출한 한국 고객사 확보

YPT

- 금도금 및 동도금 표면처리 외주 법인
- 안산에 위치, 한국 No.1 표면처리 외주 회사

Beyond Solution

- PCB용 장비 제조 및 판매

Total Solution for Customer

와이엠티는 공정의 첫 단계인 세정,박리제 부터 최종 표면처리 까지의 모든 화학소재 기술을 보유하고 있습니다.이에 저희는 고객사 설비 특성에 맞는 Total chemical solution을 제공하고 있습니다.



Finish Plating chemical

Soft ENIG Process

- ✓ CF 300 Series
- ✓ MIKO Series

ENIG Process

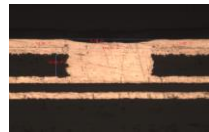
- ✓ PEN 855 Series

ENEPIG Process

- ✓ ELP Series
- ✓ IR Gold Series

TIN Plating process

- ✓ Bright and Matte finish
- ✓ Immersion tin process



Copper plating chemical

Electroless Copper plating

- ✓ Desmear Process
- ✓ HVF Series
- ✓ MJH series
- ✓ ENPLA series

Electronic Copper plating

- ✓ BJ series
- ✓ HBJ Series(Half-fill)
- ✓ VFBJ Series(Via-fill)



Process Chemical

DES Chemical

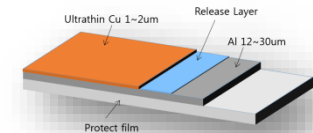
- ✓ DR Series
- ✓ SE Series
- ✓ SAC Series

Cleaner

- ✓ FXC Series
- ✓ TDF / MDF Series

Others

- ✓ Gold Recover
- ✓ Foamkiller Series
- ✓ CAROAT



Electronic Materials

Materials

- ✓ Ultra-thin copper Foil
- ✓ FCCL

Roll to Roll

- ✓ RTR 동도금 외주

기판 가공 [YPT]

Gold plating Outsourcing

- ✓ Soft ENIG / ENEPIG

Via-fill copper plating

Soft ENIG Process



- ✓ FPCB 전용 금도금 프로세스
- ✓ 글로벌 M/S 및 기술력 1위
- ✓ 초 미세회로 구현 가능
- ✓ 삼성전자, 애플 제품 탑재



Copper plating chemical

[무전해 화학동도금 화학소재]

- ✓ 세계 최고수준의 기술력 보유
- ✓ 부도체 물질에 화학적 전도 성을 부여하는 공정

[전기동도금 화학소재]

- ✓ 동의 석출로 원하는 동 두께를 도금 하는 공정
- ✓ 원하는 위치와 두께를 형성하기에 적합

ENEPIG Process



- ✓ 카메라 모듈등에 적합한 미세회로 최종 표면처리
- ✓ 글로벌 Top tier 점유율 확보
- ✓ 원가경쟁력 및 기술경쟁력 확보



회로공정 및 반도체 Chemical

[D.E.S Chemical]

- ✓ 세정,박리 등 PCB의 회로를 형성하기 위한 공정약품

[반도체 Chemical]

- ✓ Wet chemical (Cu etchant, UBM etchant) 등 신규시장 진입 Item

사업영역

Business Area

주요 고객사 List

Set Maker						
Semi-conductor Maker						
PCB Maker						
						
Display 업체						

기판 SCM의 변화

- ✓ 과거 일본 PCB 회사들이 진행하던 물량이 한국 고객사들로 이전
- ✓ 국내 FPCB회사들의 RFPCB 제조 능력 월등
- ✓ SDC의 OLED 모듈 납품으로 인하여 국내 4개사의 애플 물량 수주
- ✓ RF PCB는 층수가 높고, 동도금 공정이 사용됨에 따라 **당사의 매출 또한 시장과 연동하여 상승 전망**



SLP 시장의 개화



- ✓ SLP로 만들어진 HDI 기판의 첫 탑재
- ✓ 기존 8~12개층이던 HDI 기판이 8개층의 X 2개로 분리되어 탑재

- ✓ 기판 면적 감소로 L자형 배터리 및 모듈 탑재 증가
- ✓ **현재 국내 HDI 업체들과 소재 Test 중**

- ✓ 고해상도 Display 탑재에 따라 전송속도 증가
→ 이는 곧 고성능 PCB 탑재 요구 증가
- ✓ 과거 Multi Flex(양면 등)은 신호의 불안정성으로 고속 전송 Display에서 사용이 어려움
- ✓ 이에 따라 RF PCB는 지속적으로 성장할 것으로 예상

OLED 탑재에 따른 RF PCB 성장

Infrared Camera Dot Projector

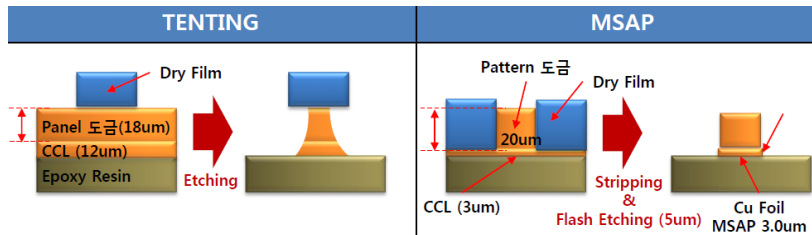


- ✓ 3D 센서 탑재로 인해 카메라 모듈수 증가
- ✓ 향후 전면 4개 / 후면 4개 탑재 예정
- **ENEPIG 물량 (약품, 기판가공) 확대 전망**

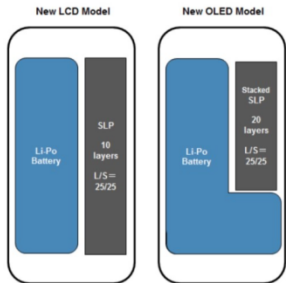
카메라 모듈의 폭발적인 증가

SLP 시장 설명

Modified Semi Additive Process



- ✓ Tenting : CCL 위 Panel 도금액을 부식시켜 회로를 형성
- ✓ MSAP : 극동박 위 Dry film 사이에 Pattern 도금을 하여 회로를 직각으로 형성



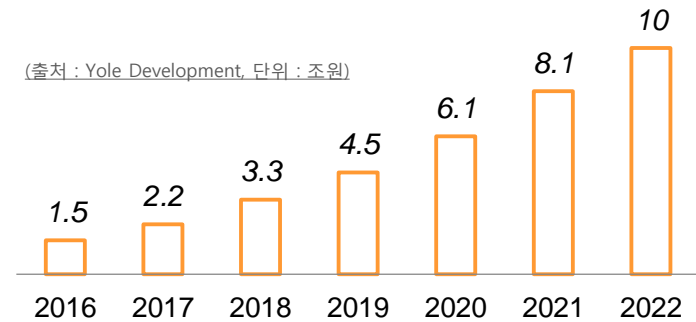
- ✓ 아이폰 X에서 획기적으로 HDI 사이즈 축소
- ✓ 향후 SLP 공법은 HDI를 비롯하여 RF PCB 등 다양한 영역으로 확대 예상

- 회로폭의 감소로 작은 면적의 기판 제작 가능
- CCL(3um) / Dry Film 박리제 / 패턴도금 등의 시장 수요 증가

카메라 모듈시장

3D 센싱 시장의 성장 전망

(출처 : Yole Development, 단위 : 조원)



3D Sensor의 모바일 탑재에 따라 카메라 모듈 시장 급성장 전망

- ✓ 전면 : 4개 → Pay와 생체보안
- ✓ 후면 : 4개 → VR 및 Entertainment 용도

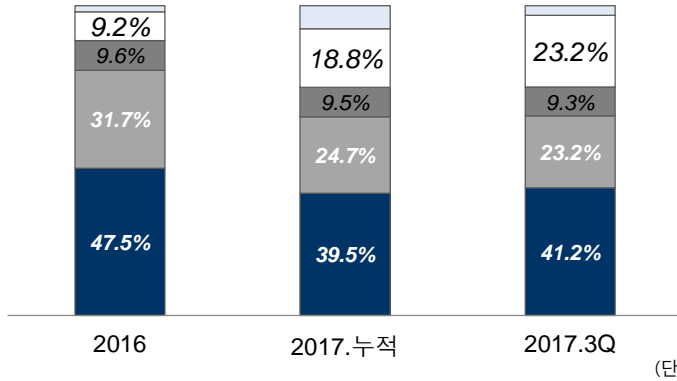
카메라 모듈용 RF PCB의 성장

회로 세밀화에 따른 **ENEPIG** , **Pure Pd** 등의 카메라 모듈 처리용 약품 매출 확대 전망

사업별 매출액 및 매출 비중

동도금 화학소재 매출 비중 확대

■기타 □동도금 ■Process ■기판가공 ■최종표면처리



	16년 온기	17년 누적	17년 3분기
Total	499	482	194
최종표면처리	237	195	80
기판가공	158	122	45
Process	48	47	18
동도금	46	93	45
기타	10	26	6

17년 분기별 재무제표

(단위 : 억원)

	제 19 기 3분기		제 18 기 3분기	
	최근3개월	누적	최근3개월	누적
I. 매출액	194.5	481.9	129.7	352.1
II. 매출원가	109.8	287.5	81.3	216.7
III. 매출총이익	84.6	194.5	48.4	135.5
IV. 영업이익	59.1	115.3	32.4	63.5
기타수익	4.7	8.8	0.6	4.8
기타비용	3.5	8.9	0.5	2.2
금융수익	1.3	3.1	2.8	10.5
금융비용	1.6	35.5	8.8	19.2
V. 법인세차감전순이익	60.0	82.8	26.5	57.4
법인세비용	12.9	24.4	8.4	13.2
VI. 분기순이익	47.1	58.4	18.1	44.2
지배기업소유주지분	40.1	43.1	16.6	37.2
비지배지분	7.0	15.3	1.5	7.0